

公司代码：688020

公司简称：方邦股份

**广州方邦电子股份有限公司**  
**2025年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。

### 2、 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

### 7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

由于报告期内公司净利润为负，同时研发投入保持较高强度，最近三个会计年度研发投入占营收的比重均超 15%，为更好推进产品技术持续创新迭代及市场开拓，综合考虑公司经营计划、研发投入及未来发展资金需求，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

## 第二节 公司基本情况

### 1、公司简介

#### 1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	方邦股份	688020	不适用

#### 1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

#### 1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王作凯	赵璇
联系地址	广州市黄埔区东枝路28号	广州市黄埔区东枝路28号
电话	020-82512686	020-82512686
传真	020-32203005	020-32203005
电子信箱	dm@fbflex.com	dm@fbflex.com

### 2、报告期公司主要业务简介

#### 2.1 主要业务、主要产品或服务情况

##### 1、主要业务

公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售，专注于提供高端电子材料及应用解决方案，现有产品主要是电磁屏蔽膜、各类铜箔、挠性覆铜板、电阻薄膜等。

其中电磁屏蔽膜、电子铜箔、挠性覆铜板和电阻薄膜是公司报告期内的主要收入来源。

##### 2、主要产品及服务情况

###### （1）电磁屏蔽膜

电磁屏蔽膜是一种厚度在微米级别、具有复杂结构的薄膜，具有抑制电子元器件电磁干扰的功能，通过贴合于FPC产生作用。现代电子产品“轻薄短小”和高频高速化趋势更加明显，驱动着电子元器件及其组件内外部的电磁干扰、以及信号在传输中衰减问题逐渐严重，对电磁屏蔽膜的需求更大，同时也提出了更高的性能要求。

公司的电磁屏蔽膜主要可分为HSF6000和HSF-USB3两大系列。其中HSF-USB3系列是2014年推出的新型电磁屏蔽膜，具备自主研发的独特微针型结构，屏蔽效能进一步提高，同时可大幅降低信号传输损耗，降低传输信号的不完整性。公司的电磁屏蔽膜产品填补了我国在高端电磁屏蔽膜领域的空白，打破了境外企业的垄断，目前大量应用于华为、小米、OPPO、VIVO、三星等知名终端品牌产品。

###### （2）铜箔产品

报告期内，公司铜箔产品主要包括带载体可剥离超薄铜箔（以下简称“可剥铜”）、各类电子铜箔。

带载体可剥离超薄铜箔是制备芯片封装基板、HDI板的必需基材。目前IC载板、类载板的线宽线距已细至10/10 $\mu\text{m}$ -40/40 $\mu\text{m}$ ，用传统的减成法制程工艺无法制备，主要使用mSAP（半加工工艺），而mSAP必须使用可剥铜。公司生产的可剥铜具有厚度极薄、表面轮廓极低、载体层和可剥离层之间的剥离力稳定可控等特性，可满足mSAP的制程要求。

电子铜箔是制造覆铜板（CCL）、挠性覆铜板（FCCL）、印制电路板（PCB）、柔性电路板（FPC）的主要原材料，主要有高温高延伸铜箔（HTE）、低轮廓铜箔（LP），主要应用于多种类常规覆铜板及线路板；反转处理铜箔（RTF），主要应用于高频高速板；超低轮廓铜箔（VLP）和高频超低轮廓铜箔（HVLP），主要应用于高频高速、低损耗要求的电路板等。报告期内公司量产的电子铜箔主要为HTE、LP和RTF，其厚度、延伸性、面密度、耐热性、表面粗糙度等指标均满足客户要求。

### （3）挠性覆铜板

挠性覆铜板（FCCL）是FPC的加工基材，由挠性绝缘层与金属箔构成。根据产品结构，挠性覆铜板可分为有胶三层挠性覆铜板（3L-FCCL）和无胶两层挠性覆铜板（2L-FCCL）；根据产品厚度，每类挠性覆铜板又分为普通型和极薄型。

下游电子产品快速发展，推动FPC制造技术向高性能化和轻薄化方向不断创新和突破，从而对FPC的高密度互连（HDI）技术要求也不断提高。FCCL是实现高密度互连技术的关键材料之一，可大幅提升电子元器件组装密度并节约组装空间，并实现超细线路FPC的制备。公司采用自研自产原材料（主要是RTF铜箔和PI/TPI）的技术路径生产FCCL，可降低生产成本，同时实现其铜层厚度及表面轮廓、剥离强度、电性能、耐热耐化性以及尺寸安定性等关键指标满足下游需求，具有良好的加工性能。

### （4）电阻薄膜（埋阻铜箔）

随着5G通讯技术应用、芯片制程日益先进以及高速高性能电子产品的骤增，电子电路发展倾向于小型化、易封装、高频高速特点。传统无源器件贴装使PCB表面焊盘增多、PCB可用表面积减少、焊盘元件间的寄生效应增加，造成高频信号传输不稳定。采用埋入式技术实现无源器件如电阻等一体化集成替代常规的表面贴装电阻，成为解决该问题的重要手段。

电阻在无源元器件中占主要组成，电阻埋入电路板内部带来的好处并不仅仅是节约了电路板表面的空间，而且电路板表面焊接点将产生电感量，埋入的方式消除了焊接点，因此也就减少了引入的电感量，从而降低了电源系统的阻抗。同时由于消除了焊接点（电路板上最容易引入故障的部分），可靠性也得到了明显提高。

相比于传统电阻元器件，电阻薄膜成为替代传统表面贴装电阻器件的最佳技术路线，在电阻功率放大、电压转换、信号输入/输出、温度补偿和电源滤波等方面发挥着重要作用。

## 2.2 主要经营模式

### 1、采购模式

公司采用“以产定购、批量订购”的采购模式，由采购人员根据各个品种需求量和生产计划时间以及库存情况，确定每个品种的订购批量并发出订货需求单。公司的采购体系执行ISO9000

标准，采购价格确定方式主要采用询价模式。

## 2、生产模式

公司采用“以销定产、需求预测相结合”的生产模式，由市场部接到客户订单或需求后向生产部门下达生产指标，生产部门根据订单情况及产品库存情况安排相应的生产计划。

公司电磁屏蔽膜核心生产环节包括载体膜表面处理、绝缘层涂布、金属合金层形成、微针状金属层形成、导电胶层涂布等，铜箔生产核心环节为溶铜、生箔、后处理等，挠性覆铜板生产核心环节包括混胶合成、涂布、真空溅射、压合等。公司的产品为高端电子材料，生产工艺复杂，技术含量高，为有效控制产品质量，防止技术秘密外泄，逐步形成了高度自主的生产模式，上述生产环节均由公司自主完成，不存在外协加工的业务模式。公司对生产技术和产品质量控制标准实行严格管控，在生产过程中由检验人员和检测设备对生产流程全过程进行监测，并对最终产品进行质量检验。

## 3、销售模式

报告期内，公司的销售模式为直销模式，直接客户为线路板厂商和覆铜板厂商，最终用户为智能手机、平板电脑以及汽车行业等品牌厂商。

公司一方面根据市场调研、行业变化趋势、技术进步等情况，自行针对目标市场进行产品开发，为下游客户提出解决方案；另一方面，公司和下游客户以及终端品牌厂商建立了良好的合作关系，形成了良性互动。公司根据下游客户的需求进行针对性的产品开发和销售。

产品开发完成后，由下游客户进行打样、工艺验证和基本性能测试，通过后由封装/终端品牌厂商进行整体性能测试，之后通过小批量试产，验证品质的稳定性后即可进入终端产品的物料清单。待相关方就商务条款达成一致，公司即可量产、销售。

## 4、研发模式

公司长期坚持自主创新，采用定制式研发和主动式研发相结合的方式。在定制式研发方面，通过与下游终端厂商的技术交流，了解下游终端厂商对电磁屏蔽膜、超薄铜箔、挠性覆铜板等产品的个性化需求，进行定制式研发。在主动式研发方面，采用自主研发的设备，依靠自身积累的经验，根据市场需求，设计产品，生产部门配合研发实验室进行测试确认，不断优化实验方案，不断改进，最终确定方案进行小批量试产，试产成功后再进行大批量生产，逐步提升现有产品的性能。

### 2.3 所处行业情况

#### (1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

##### ①所处行业

公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售，根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C3985 电子专用材料制造”。

##### ②行业发展阶段及基本特点

电子专用材料制造行业是支撑国民经济和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其发展程度是一个国家科技发展水平的核心指标之一。电子专用材料行业发展不充分，将导致其下游产业如芯片封装、高性能高精密线路板制备密切相关的5G通讯、人工智能、大数据中心、汽车电子等战略领域须依赖进口原材料，形成“卡脖子”困境。近年来，国家颁布了一系列政策法

规，将信息技术和电子专用材料制造确定为战略性新兴产业之一，大力支持其发展。2018年颁布的《战略性新兴产业分类》，明确将“电磁屏蔽膜”、“高频微波、高密度封装覆铜板”、“PCB用高纯铜箔”等电子专用材料列为重点产品。高端电子专用材料自主可控和国产替代的重要性持续提升。

报告期内，公司量产产品主要为电磁屏蔽膜和各类铜箔，并布局挠性覆铜板、带载体可剥离超薄铜箔、电阻薄膜等高端电子材料，直接下游客户主要为线路板（PCB）厂商、覆铜板厂商，应用终端以消费电子为主，部分应用于汽车电子、人工智能（AI）、先进封装等领域。

从行业发展历程看，PCB及上游电子专用材料行业早期主要受消费电子需求拉动，智能手机、平板电脑、可穿戴设备等终端产品的普及，推动了FPC、FCCL、电磁屏蔽膜、电子铜箔等细分领域持续发展。近年来，随着全球电子产业加快向高算力、高速通信、高可靠性方向演进，行业发展重心逐步由传统消费电子领域向人工智能、数据中心、汽车电子、先进封装等新兴应用领域延伸，行业整体处于由传统消费电子需求主导向多元新兴需求共同驱动的结构升级阶段。PCB兼具精密电路互联、低损耗信号传输和稳定机械支撑等作用，被广泛应用于消费电子、通信设备、数据中心、汽车电子、航空航天等领域，是电子信息产业的重要基础。根据Prismark预测，2025年全球PCB市场将增长约6.8%，到2029年全球PCB产值将达到约946.6亿美元，2024年至2029年复合增长率约为5.2%，表明行业整体仍处于持续增长通道。

消费电子仍是PCB及上游电子专用材料最重要的应用领域之一，也是公司电磁屏蔽膜、FCCL等产品当前最主要的终端应用场景。根据IDC预测，2025年全球智能手机出货量将同比增长1.5%至12.5亿部，显示消费电子需求总体仍处于温和修复阶段。随着智能手机、平板电脑、可穿戴设备等终端持续向轻薄化、高性能化、集成化方向升级，下游客户对电磁屏蔽性能、信号传输性能、材料厚度控制、耐弯折性及可靠性等方面的要求也不断提高，从而带动相关电子专用材料持续迭代升级。

与此同时，人工智能相关应用的快速发展正成为PCB行业的重要增量来源。AI服务器、数据中心、高速交换机、光模块等领域需求持续增长，推动PCB产品加快向高多层、高密度互连、高频高速、低损耗和高可靠性方向升级。根据Prismark预测，2023年至2028年AI服务器相关HDI的年均复合增速将达到16.3%，反映出行业增长重心正逐步由传统消费电子转向AI算力基础设施等高端应用领域。另一方面，在国际贸易摩擦、地缘冲突及产业链安全因素影响下，高端电子专用材料自主可控的重要性进一步凸显，国产替代进程有望持续推进。整体来看，公司所处电子专用材料行业仍处于重要发展机遇期，消费电子需求仍为行业提供重要支撑，人工智能、先进封装、汽车电子等新兴领域则正成为推动行业升级和结构优化的重要力量。

## (2) 公司所处的行业地位分析及其变化情况

### ①公司在行业内拥有较强技术水平，部分产品对标国外，满足供应链本土化

在电磁屏蔽膜领域，公司具有重要的市场、行业地位，市场占有率较高。公司的电磁屏蔽膜产品填补了我国在高端电磁屏蔽膜领域的空白，打破了境外企业的垄断。

在挠性覆铜板领域，其主要原材料是铜箔、聚酰亚胺（PI）和热塑性聚酰亚胺（TPI），公司采取自研自产原材料的策略来生产挠性覆铜板，以逐步打破对国外上游供应链的依赖，建立核心竞争优势和技术壁垒，大幅降低生产成本，提升产品市场竞争力和经济效益。另一方面，制备极薄

挠性覆铜板等高端产品，对铜箔厚度、粗糙度以及产品整体剥离力等要求很高，公司现有的技术、工艺和配方可满足以上技术需求。对于极薄挠性覆铜板，目前该产品全球量产供应商主要为日本的东丽和住友。公司自主研发生产的极薄挠性覆铜板，其铜层厚度及表面轮廓、剥离强度、电性能、耐热耐化性以及尺寸安定性等关键指标国际先进，具有优异的加工性能。

在超薄铜箔领域，公司生产的带载体可剥离超薄铜箔，目前该产品全球量产供应商主要为日本的三井金属。公司自主研发生产的超薄铜箔，其铜层厚度及表面粗糙度、剥离强度、抗拉强度等关键指标达到世界先进水平。

## ②公司产品得到行业内众多知名客户认可并建立了稳定的合作关系

凭借良好的产品性能、持续的技术创新以及快速的服务响应，公司积累了鹏鼎、MFLEX、弘信、景旺、BHflex、群策、深南、生益科技、兴森、台光等众多优质直接客户，并与华为、小米、OPPO、VIVO、三星以及相关头部芯片厂商等知名终端客户保持密切的技术交流与合作。

## (3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

### ①电磁屏蔽膜

电磁屏蔽膜将受益于 5G-5.5G-6G 通讯、人工智能、汽车电子、虚拟现实技术等行业的快速发展。5G-5.5G-6G 环境下，以智能手机、AR/VR 硬件设备为代表的消费电子产品“轻薄短小”、高频高速化趋势愈加明显，其内部结构 FPC 使用量不断增加以提升内部组装密度，同时电子元器件之间的电磁干扰亦愈加严重，这客观上加大了对电磁屏蔽膜的需求，这种需求一方面体现为电磁屏蔽膜使用量的增加，另一方面体现为电磁屏蔽膜性能提升的要求（如厚度更薄、屏蔽效能更高、插入损耗更低、耐弯折性更强、抗撕裂性更强等）。

折叠手机、AI 手机也对电磁屏蔽膜提出了新的需求。折叠手机要求电磁屏蔽膜更薄、更耐弯折。AI 手机方面，据市场分析机构 Canalys 最新预测数据显示，2024 年全球 AI 手机出货量占智能手机总出货量的 16%，到 2028 年这一比例将激增至 54%，年复合增长率（CAGR）为 63%，AI 手机的高算力性能引发手机内部明显的散热问题，要求电磁屏蔽膜在屏蔽功能的基础上承担部分散热功能。

在国家“碳达峰、碳中和”目标提出之后，我国新能源汽车推广普及进程加快，新能源汽车智能化趋势明显。随着汽车向电动化、智能化发展，FPC 在弯折性、减重、自动化程度高等方面的优势进一步体现，FPC 在车载领域的用量不断提升，应用涵盖显示模组、车灯、BMS/VCU/MCU 控制系统、传感器、自动驾驶辅助系统等相关场景，市场预计单车 FPC 用量将超过 100 片。在上述 FPC 应用场景中，又因显示模组有其高清化需求，以及传感器系统需要接收 5G 信号、毫米波等高频高速信号以实现短延迟甚至零延迟的探测反馈和自动驾驶，这些高频高速电路存在对电磁屏蔽的潜在需求。

### ②挠性覆铜板

作为 FPC 的加工基材，挠性覆铜板将受益于 FPC 市场需求扩大及其细线化趋势。据市场分析机构 Prismark 数据及预测，近 10 年内，全球 FPC 产值规模不断扩张，复合增长率约 3.3%，预计 2028 年全球 FPC 产值有望达到 151.17 亿美元；另一方面，各类电子产品“轻薄短小”、高频高速化趋势愈加明显，倒逼 FPC 线宽线距越来越精细，这加大了对高性能挠性覆铜板（如无胶二层 FCCL、极薄 FCCL）的需求，因为此类挠性覆铜板的铜箔厚度更薄、表面轮廓更低、剥离力更强且尺寸安

定性更高，更能满足细线路 FPC 的加工制程。

另外特别值得注意的是新能源汽车对 FPC 的需求不断增大，对上游基材挠性覆铜板形成较强烈利好。一方面，动力电池 FPC 替代铜线线束趋势明确。相较铜线线束，FPC 由于其高度集成、超薄厚度、超柔软度等特点，在安全性、轻量化、布局规整等方面具备突出优势，此外 FPC 厚度薄，电池包结构定制，装配时可通过机械手臂抓取直接放置电池包上，自动化程度高，适合规模化大批量生产，FPC 替代铜线线束趋势明确，目前国内动力电池主流厂商已经在 Pack 环节批量化应用 FPC。另一方面，FPC 厂商进一步向下游 CCS（Cells Contact System，集成母排，线束板集成件）产品布局，通过 FPC 向 CCS 的拓展提升单车价值和盈利空间。CCS 产品由 FPC、塑胶结构件、铜铝排等组成，铜铝排将多个电芯通过激光焊接进行串并联，FPC 通过与铜铝排、塑胶结构件连接从而构成电气连接与信号检测结构部件。

### ③铜箔产品

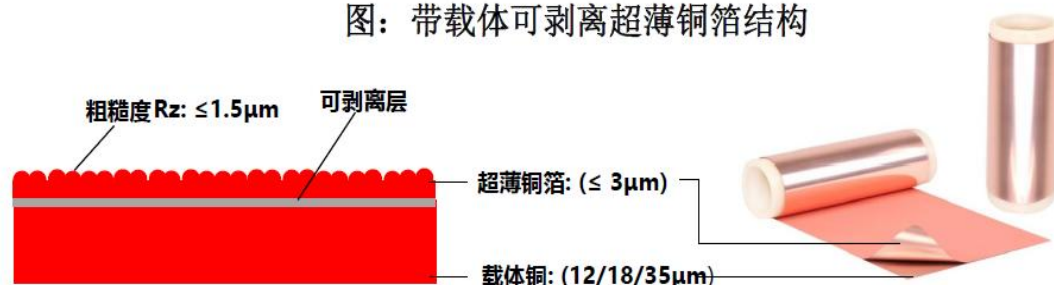
公司铜箔产品包括带载体可剥离超薄铜箔、电子铜箔等。

**带载体可剥离超薄铜箔**是芯片封装基板（IC 载板、类载板）、HDI 板的基材，将受益于芯片制程先进化进程。

目前，半导体芯片技术快速发展、制程日益先进，客观上带动芯片封装领域的 IC 载板、类载板的细线化成为必然趋势，目前 IC 载板、类载板布线最小线宽线距已细至 10/10 $\mu\text{m}$ ，由于其线宽线距极细，用传统的减层法制程工艺无法制备，主要使用 mSAP。mSAP 是制备芯片封装基板、类载板的主流技术路线，目前，鹏鼎控股、深南电路、安捷利-美维电子、三星电机等国内外大型电路板厂商均主要采用 mSAP 制备 IC 载板、类载板等。

**一般铜箔无法满足 mSAP 制程要求，必须用到带载体可剥离超薄铜箔。**用于 mSAP 工艺的铜箔，必须满足以下关键条件：**A.厚度 $\leq 3\mu\text{m}$** ，若无法达到该标准，mSAP 将无法稳定“闪蚀”过厚的铜层，届时将依旧存在减成法特有的“侧蚀”现象，无法制作精细线路；**B.表面轮廓  $R_z \leq 1.5\mu\text{m}$** ，若无法达到该标准，过高的铜层表面粗糙度闪蚀不掉，无法制作精细线路，同时也会严重影响 IC 载板、类载板的高频高速特性；**C.必须带有载体层和可剥离层**，由于薄铜太薄，无法直接应用于实际加工，必须依赖载体层加以辅助稳定；同时，实际加工过程中，只有薄铜最终应用到精细线路制作，载体层必须撕掉，因此必须在薄铜与载体层之间设置可剥离层，同时，必须形成剥离力稳定可控的可剥离层，剥离力过高或过低，都将导致实际加工失败，因此剥离力是制备带载体可剥离超薄铜箔的重大技术难点。

图：带载体可剥离超薄铜箔结构



当前，国内外高端芯片龙头企业对带载体可剥离超薄铜箔存在较大需求，以实现先进制程芯

片与基板的精密互连。然而，带载体可剥离超薄铜箔全球市场被日本三井铜箔垄断，卡脖子问题严重，对与我国高端芯片封装领域密切相关的5G通讯、人工智能、大数据中心、汽车电子等关键行业造成较大制约，实现带载体可剥离超薄铜箔的供应链本土化需求较为迫切。

**电子铜箔领域。**电子铜箔是覆铜板、印制电路板的主要原材料，随着5G通信、计算机、汽车电子、物联网、人工智能等行业不断发展与进步，预计电子电路铜箔市场仍将保持增长态势。当前，随着人工智能（AI）服务器需求持续增长，高端高密度互连板（HDI）、高多层板、类载板等成为电子电路板领域的重要增长方向，其对高端电子铜箔的需求随之提升。根据GGII统计及预测，到2030年全球电子电路铜箔出货量将达到82.3万吨，中国电子电路铜箔出货量将达到53.8万吨，2021年至2030年复合增长率分别为3.1%和4.8%。其中，对高频、高速、低损耗的高性能铜箔需求将持续增长，而高频高速铜箔目前我国仍主要依赖进口，国产替代空间广阔。

#### ④电阻薄膜（埋阻铜箔）

电阻薄膜将电阻埋入线路板内部线路，除已应用于消费电子产品声学模块外，还可应用于低轨卫星等航空航天场景，一方面可减轻航天器重量，降低发射成本；另一方面取消了传统焊点，可较大幅度提升信号完整性和模块功能稳定性，从而提升航天器在太空环境的品质可靠性。

在常规电阻薄膜的基础上，公司还开发了热敏型薄膜电阻，其可随温度的变化而呈现阻值变化，适用于电子产品内部的芯片主动热管理。随着新能源汽车、AI技术的高速发展，芯片制程愈加先进，运算速度愈加高速化，由此带来了愈加广泛而严重的芯片发热、散热问题。热敏型薄膜电阻植入于芯片组件与主板连接部分，可及时、精确地感知温度细微变化，进而通过软硬件的设计来实现芯片的主动热管理。热管理是新一代电子产品必须解决的普遍而迫切问题，目前该产品正处于相关客户的测试流程中。

### 3、公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	1,750,196,681.47	1,800,120,282.08	-2.77	1,945,328,988.11
归属于上市公司股东的净资产	1,330,014,207.91	1,374,196,062.02	-3.22	1,484,916,098.58
营业收入	357,636,948.88	344,570,817.57	3.79	345,149,314.31
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	333,480,628.50	306,986,897.88	8.63	329,331,001.93
利润总额	-75,389,662.56	-89,749,018.36	不适用	-68,268,860.12
归属于上市公司股东的净利润	-83,622,365.83	-91,642,742.25	不适用	-68,670,118.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-93,470,818.06	-112,768,813.12	不适用	-85,851,515.65
经营活动产生的现金流量净额	1,621,296.96	-45,967,720.46	不适用	-12,803,081.70

加权平均净资产收益率(%)	-6.24	-6.43	增加0.19个百分点	-4.54
基本每股收益(元/股)	-1.26	-1.14	-10.53	-0.86
稀释每股收益(元/股)	-1.24	-1.13	-9.73	-0.85
研发投入占营业收入的比例(%)	17.38	17.97	减少0.59个百分点	16.10

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	88,730,690.51	83,611,181.56	95,964,238.07	89,330,838.74
归属于上市公司股东的净利润	1,435,622.28	-25,293,489.49	-2,825,421.55	-56,939,077.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,095,667.50	-28,689,476.66	-12,958,028.38	-48,727,645.52
经营活动产生的现金流量净额	-26,028,819.46	31,453,682.83	20,479,460.87	-24,283,027.28

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4、 股东情况

### 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,312
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,015
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)	

股东名称 (全称)	报告期内增減	期末持股 数量	比例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
胡云连	0	14,555,802	17.67	0	无	0	境内自然人
广州力加电子有 限公司	0	14,086,260	17.1	0	无	0	境内非国有 法人
海南美智电子有 限合伙企业(有 限合伙)	0	7,200,000	8.74	0	无	0	境内非国有 法人
易红琼	0	4,979,672	6.05	0	无	0	境内自然人
李冬梅	60,000	2,428,089	2.95	0	无	0	境内自然人
申小玲	908,122	908,122	1.1	0	无	0	境内自然人
章金楠	20,000	810,000	0.98	0	无	0	境内自然人
姜雨	803,110	803,110	0.97	0	无	0	境内自然人
姜仕鹏	686,831	686,831	0.83	0	无	0	境内自然人
高盛公司有限责 任公司	510,444	524,694	0.64	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡云连、广州力加电子有限公司、广州美智电子有限 合伙企业(有限合伙)、李冬梅是公司控股股东;苏 陟、胡云连、李冬梅为公司实际控制人,其中苏陟与 李冬梅为夫妻关系,共同控制广州力加电子有限公 司、广州美智电子有限合伙企业(有限合伙),除此 之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属 于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明	无						

**存托凭证持有人情况**

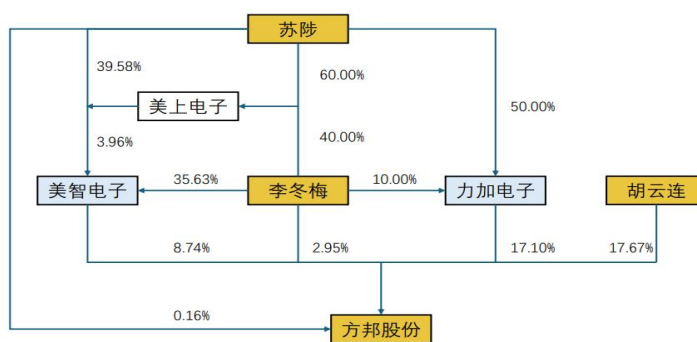
适用 不适用

**截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

适用 不适用

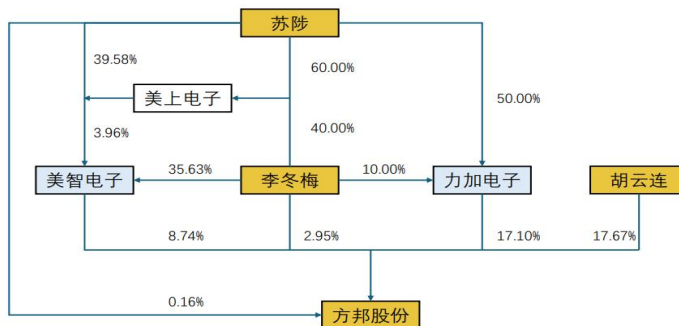
**4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用  不适用

5、公司债券情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 35,763.69 万元，较上年增长 3.79%；归属于母公司所有者的净利润为-8,362.24 万元，较上年同期亏损收窄 802.04 万元，主要系：（1）屏蔽膜业务：受全球智能手机需求放缓、产业链竞争加剧及终端客户持续推进降本影响，屏蔽膜销售收入同比下降 5.75%，毛利较上年减少 274.63 万元；与此同时，高端屏蔽膜销量同比增加 19.77 万平方米，产品结构持续优化，在一定程度上对冲了普通产品销量下滑带来的不利影响。（2）新产品业务：公司新产品逐步放量，其中电阻薄膜（埋阻铜箔）销售额大幅增长，对公司营业收入和利润形成一定贡献；FCCL 产品销售额同比增长 71.21%，随着销售规模提升带动固定成本逐步摊薄，FCCL 业务亏损较上年同期有所收窄，经营改善趋势逐步显现。（3）铜箔业务：公司持续推进铜箔业务产品结构优化，业务毛利亏损有所减少。其中，可剥铜已通过相关代表性载板厂商和头部芯片终端的量产认证，持续获得小批量订单，销售额于本年度保持增长，国产替代趋势进一步显现；此外，毛利相对较高的 RTF 铜箔实现较快增长，销售额同比增长 339.45%，对铜箔业务结构改善和盈利能力修复形成积极支撑。（4）其他收益影响：报告期内，可剥铜专项受托开发项目已通过客户结项验收，确认相应收入，增加利润 929.25 万元，对本期业绩形成正向贡献。（5）减值及公允价值变动影响：受铜箔业务持续亏损影响，公司基于审慎性原则，对铜箔相关固定资产组计提减值准备 2,498.72 万元，较上年同期增加减值 950.07 万元；同时，公司对江苏上达半导体有限公司的投资，其 COF 业务具备一定发展前景，但因标的公司实际控制人违规对外担保导致其承担较大债务，公司出于财务审慎原则计提该笔投资公允价值变动损失 1,500 万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用